

## Samsung Galaxy S7 傳用鎂合金機身：又硬又輕，散熱效能更強

發表於 2015 年 9 月 21 日



圖為 Galaxy S6 及 Galaxy S6 Edge

今年 Samsung 的旗艦 Galaxy 手機，一改塑膠機身的設計，以超薄的機身，金屬的側框，並加入玻璃機背的設計，感覺令人眼前一亮。不過，習慣每年改設計的 Samsung，傳聞會在旗艦機 Galaxy S7 身上，設計方面花更多心機，繼續為用家帶來設計出眾的手機產品。

Samsung Galaxy S7 的設計，有傳會採用鎂合金打造一體化的機身。相信本網的讀者，對鎂合金這材料都不會感覺陌生。鎂合金就是不少旗艦級相機機身，製作機殼的物料，鎂合金有著比鋁強 2.8 倍的硬度，重量更輕 65%，而且散熱效能更高。鎂合金用於熱量較高的 2K 解像度手機屏幕身上，看來亦會十分適合。

現在超過 5.5 吋屏幕的金屬機身手機，普遍重量接近、甚至超過 170g，長時間使用，手腕還是會感覺疲勞。現在 Samsung 傳聞研究採用鎂合金打造手機機身，相信用於大屏幕手機身上，用戶更能看出採用鎂合金機身的優點。不過，筆者認為用戶不會因為機身更堅硬而買機，與其研究全新

的機身物料，倒不如考慮重新加入 Micro SD 咭的功能，對用戶來說，可能感覺更實際一點。

資料來源：inews24